

2-440054-4 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 2-440054-4
PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, Signal, Blue
[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen > AMP HPI 2.0 mm Headers



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **4**

Raster: **2 mm [.079 in]**

[Alle AMP HPI 2.0 mm Headers \(220\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	4
Zeilenanzahl	1

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	250 VAC
-----------------	---------

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Blau
----------------------	------

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	3.35 mm[.131 in]
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.5 mm[.02 in]
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Hell

Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Hell
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	2.032 µm[80 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.5 mm[.02 in]
Anschlüsse pro Pfosten (max.)	3
Anschlussstift- und Restlänge	3.4 mm[.134 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötten

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Gegensteckführung	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Geknickte Zacken
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	2 mm[.079 in]
Gehäusematerial	Nylon 66 GF

Abmessungen

Steckverbinderlänge	10 mm[.393 in]
Steckverbinderhöhe	6.05 mm[.238 in]
Steckverbinderbreite	4.7 mm[.185 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1 – 1.6 mm[.039 – .063 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	300
------------------	-----

Verpackungs-Typ	Tasche
-----------------	--------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
--	---

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
---------------	--

Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 240 °C
--------------	---------------------------

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

HPI 2.0MM,HDR,4POSVERTICAL,BLU

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-440054-4_F4.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-440054-4_F4.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-440054-4_F4.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



Datenblätter/ Katalogseiten

[HPI Connectors QRG](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch